

【お知らせ】

2014 年 7 月 17 日

フェリカネットワークス株式会社

**NFC 標準規格に準拠した次世代モバイル FeliCa IC チップ の量産出荷開始を
Samsung、ソニー、東芝、それぞれと合意
～日本でも世界でも使える非接触 IC サービスの普及を促進～**

フェリカネットワークス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 眞鍋 マリオ、以下フェリカネットワークス）は、Samsung Electronics Co., Ltd.、ソニー株式会社、株式会社東芝それぞれと、NFC 標準規格に準拠した次世代のモバイル FeliCa IC チップ（第 3 世代）を開発し、その量産出荷開始について合意しました。これにより、世界標準規格の策定が進み、普及が拡大している近距離無線通信技術 Near Field Communication（以下 NFC）との融合を図ることで、日本でも世界でも使える非接触 IC サービスの普及を促進していきます。

フェリカネットワークスが開発した「モバイル FeliCa IC チップ」は 2004 年に出荷を開始し、2010 年からはおサイフケータイ対応スマートフォン（Android）への搭載も開始されており、これまでの累計出荷数は 2 億 4500 万個（2014 年 6 月末現在、当社調べ）を超えています。その安心、安全、便利な機能は、電子マネー、クレジット、交通チケット、会員証など多くのサービスでご利用いただいております。

モバイル機器と通信環境がグローバルな展開を示している市場環境において、モバイル FeliCa で築いた技術とノウハウを最大限に生かし、NFC 標準規格も取り込んだシステム、サービスの展開へと進化を進めてまいりました。当社は、更なる安心、安全、便利なサービスを日本だけでなく世界で実現することを目指してまいりました。この度、当社がパートナーの 3 社と開発が完了し、本年夏から量産出荷を開始する新しいモバイル FeliCa IC チップは、今後スマートフォンをはじめとしたモバイル端末に順次搭載される見込みです。

<第 3 世代モバイル FeliCa IC チップの特徴>

1. 世界初*、NFC 標準規格に準拠し日本でも世界でも使えるチップ

世界で初めて、日本の FeliCa 対応サービスとの互換性があり、NFC 標準規格にも準拠したスマートフォンをはじめとしたモバイル端末向けチップです。海外の FeliCa 対応サービスや NFC サービスにも対応可能なため、携帯メーカーの端末個別カスタマイズ負荷を軽減します。

※2014 年 7 月現在、フェリカネットワークス調べ

2. セキュリティーを強化、さらに安心、安全なサービス実現をサポート

暗号方式として、トリプル DES に加え、AES(128bit)に対応。セキュリティーマイグレーション機能にも対応し、サービス事業者様でのフレキシブルなセキュリティー強化を実現します。

3. モバイル機器への搭載に求められるチップサイズの更なる縮小

従来チップに比べて 40%以上のチップサイズ縮小を実現し、スマートフォンをはじめとしたモバイル機器へのチップ搭載を一層容易にします。

今後、当社は社会的インフラの主力を担うプラットフォーマーとして、非接触 IC 技術を軸に、“かざす”ことを通して新しいコミュニケーションを創造し、世の中をより便利に楽しく変えることを目指して、モバイル機器と非接触 IC 技術を融合したサービスを世界に広めてまいります。